

## RBL型 リボウリング 治具(リードピッチ0.5~0.8mmCSPに推薦)

---

BGA(CSP)のリボウリングが容易に可能です。

RBL型リボウリング 治具はメタルマスクの交換で、あらゆるサイズのBGA(CSP)のリボウリングが可能です。

半田ボール搭載後のBGA(CSP)は、そのままリワーク装置で加熱し完成させます。

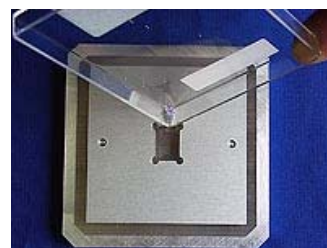
リボウリングには、SND型の印刷 治具を併用します。

### RBLリボウリング 治具の概要

RBLリボウリング 治具は、予めBGA(CSP)のボールパターンにあわせてメタルマスクの製作が必要です、メタルマスクのボール孔に溶剤ボールを落とし込み、予めクリーニングしたBGAを載せて加熱し、溶剤ボールをパッケージへ固定して完成です。



RBLリボウリング 治具



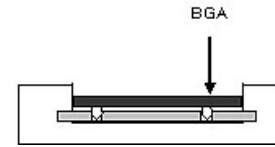
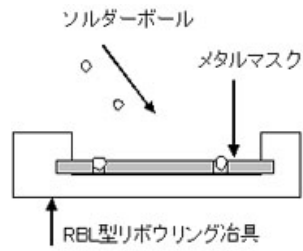
はんだボール供給



はんだ印刷

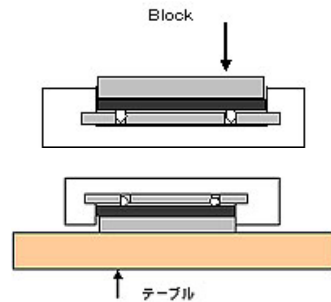
## リボウリングのプロセス

メタルマスクに溶剤ボールを乗せて、余分な溶剤ボールを取り除きます。



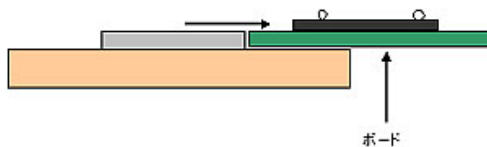
次に予め印刷されたBGAを載せます。

BGAにブロックを乗せて作業台の上で反転させます。



作業台上で、RBL治具部を取り除くと、ブロックの上にBGAが乗った状態となります、BGAには溶剤ボールが揃って搭載されていることを確認してください

ブロック上にあるBGAを加熱用の基板に移動させます。



基板に載せたBGA(溶剤ボールが上)を、リワーク装置で加熱し、溶剤ボールをBGAパッケージへ固定させます。リワーク装置の加熱条件は、最適加熱温度プロファイルを使用し、実際には溶剤ボールがパッケージ上へ固定される状態が確認できる温度(出来るだけ低い温度で)で充分でしょう。

